

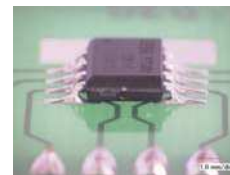
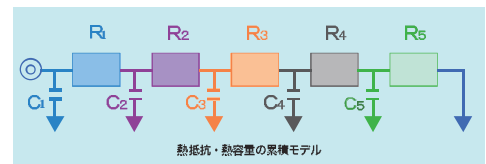
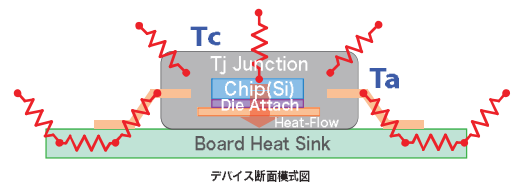
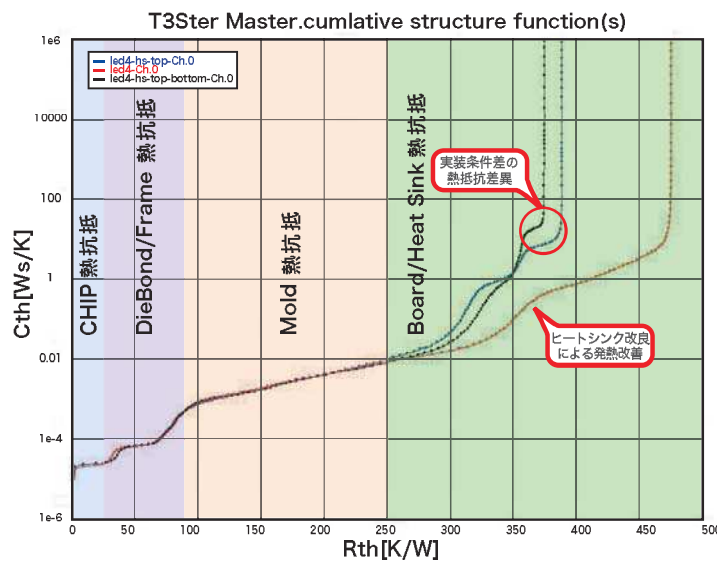
パッケージ過渡熱解析サービス

- ◆ 各種ICパッケージ内の熱抵抗特性 (熱抵抗・熱容量) を測定します
- ◆ TEGを作製する必要はありません。製品状態で測定が可能です
- ◆ JEDEC JESD 51-1 Standardにも対応可能です
- ◆ 故障解析・構造解析の非破壊解析ツールとして利用可能です



過渡熱解析例

各構成材料の熱抵抗を非破壊で解析することができます



応用範囲

過渡熱測定 of 構造関数より熱抵抗・熱容量を導き出します
各種半導体電子部品に対応します

[ダイオード, トランジスタ, MOSFET, ICs, LED等]

各種環境条件に対応します

- ・ JEDEC、温度・湿度環境、無風・気流条件
- ・ 単体、基板実装、ヒートシンク付加、コールドグリース条件



故障解析・構造解析・スクリーニングをサポートします



解析装置

過渡熱解析はメンターグラフィックス社製 T3Sterを使用しています



Mentor Graphics Corporation
Thermal Transient Tester
T3Ster

諸仕様
最大出力：50V/2A (100W)
測定レンジ：50mV, 100mV, 200mV, 400mV
解像度：12bit

※装置写真にメンター・グラフィックス・ジャパン株式会社より提供いただいたものを示します。